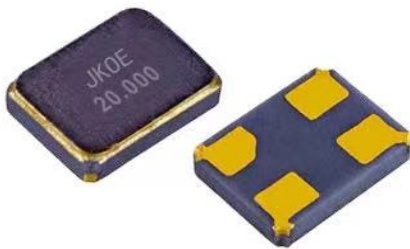


X25F



产品特点及应用范围:

- 体积小
 - 准确度高
 - 陶瓷封装
 - 盘带包装
 - 可回流焊接
- 视听设备
 - 蓝牙
 - 物联网
 - 工业控制

产品性能

性能参数		X25F
频率范围 (MHz)	F ₀	12.000~54.000
振动模式	Mode	AT 基频
串联谐振电阻 (Ω)	R _r	见等效电阻对照表
频率精度 (25℃ 时)	F _{tol}	±5×10 ⁻⁶ ~±30×10 ⁻⁶
储存温度范围	T _{stg}	-55℃~+125℃
静电容	C ₀	7pF Max.
负载电容	CL	6pF~30pF 或串联
绝缘电阻	IR	>500MΩ DC/100V±10V
激励功率	DL	0.01mW~0.1mW
老化率	F _{age}	±3×10 ⁻⁶ /年 Max.

频率温度稳定度选型表

工作温度范围	频率稳定度					
	O:±10×10 ⁻⁶	P:±15×10 ⁻⁶	Q:±20×10 ⁻⁶	S:±30×10 ⁻⁶	T:±50×10 ⁻⁶	U:±100×10 ⁻⁶
B: -10℃ ~ +60℃	●	●	●	●	●	●
C: -20℃ ~ +70℃	●	●	●	●	●	●
ΔG: -40℃ ~ +85℃			●	●	●	●
▽Q: -40℃ ~ +125℃					◎	◎

●: 可选产品 ◎: 定制产品 Δ: 工业级 ▽: 汽车级

外形尺寸 (mm)

